

F-WS箔 (両面平滑箔)

概要

電解銅箔の優れた結晶構造と圧延銅箔の耐屈曲特性を兼ね備えた、FPC用途の電解銅箔です。F-WSシリーズの種々の電解銅箔は、優れた表面粗化処理技術により開発され、あらゆる樹脂との密着を可能にします。

特長

圧延銅箔と同等の屈曲性を有しながら結晶構造は微細です。
 ファインパターンが作製可能な低粗化処理は、密着性にも優れます。
 COF等に使用されている2層FPC向け電解銅箔として、圧倒的な国内シェア実績を誇ります。
 2層FPCとして、携帯電話やノートパソコンのヒンジ部に採用されております。
 メーター幅での対応も可能です。

代表的な用途

フレキシブル基板

仕様

F0-WS

項目		箔厚 [μm]		
		9	12	18
質量厚さ [g/m ²]		81	107	153
引張強さ [N/mm ²]	常温	310		
	180	180		
伸び [%]	常温	5	7	10
	180	-	12	14
表面粗さ (Rz) [μm]	粗化面	1.5		
	光沢面	1.6		
ピール強度 [kN/mm ²]	FR-4	-		
	高耐熱樹脂	-		

F1-WS

項目		箔厚 [μm]		
		9	12	18
質量厚さ [g/m ²]		81	107	153
引張強さ [N/mm ²]	常温	310		
	180	180		
伸び [%]	常温	5	7	10
	180	-	12	14
表面粗さ (Rz) [μm]	粗化面	1.9		
	光沢面	1.6		
ピール強度 [kN/mm ²]	FR-4	-		
	高耐熱樹脂	-		

F2-WS

項目		箔厚 [μm]		
		9	12	18
質量厚さ [g/m ²]		81	107	153
引張強さ [N/mm ²]	常温	310		
	180	180		
伸び [%]	常温	5	7	10
	180	-	12	14
表面粗さ (Rz) [μm]	粗化面	2.1		
	光沢面	1.6		
ピール強度 [kN/mm ²]	FR-4	0.8	0.9	1.0
	高耐熱樹脂	0.7	0.8	0.9

F3-WS

項目		箔厚 [μm]	
		12	18
質量厚さ [g/m ²]		107	153
引張強さ [N/mm ²]	常温	310	
	180	180	
伸び [%]	常温	7	10
	180	12	14
表面粗さ (Rz) [μm]	粗化面	2.6	
	光沢面	1.6	
ピール強度 [kN/mm ²]	FR-4	1.0	1.1
	高耐熱樹脂	0.9	1.0